

天水华天科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，严格遵守有关法律法规及公司各项制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，有效推动了公司的稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、行业竞争格局和发展趋势

1、全球半导体市场发展情况

得益于算力芯片需求增长和存储芯片需求回暖以及价格回升的驱动，2024 年全球半导体市场结束了 2022 年下半年开始的下行调整，正式进入复苏上行周期。2024 年全球半导体月度销售额波动回升，并于 8 月份首次超过 2022 年 5 月的纪录，达到当时的历史最高水平，并在随后几个月继续保持增长。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2024 年全球半导体销售额达到 6,276 亿美元，同比增长 19.1%，首次突破 6,000 亿美元大关。

从产品类别来看，逻辑集成电路产品销售额达到 2,126 亿美元，继续成为半导体销售额最大的产品类别；存储类集成电路销售额实现 78.9% 的大幅增长，达到 1,651 亿美元，其中 DRAM 产品销售额同比增长 82.6%，是半导体各类别中增幅最大的产品。

展望 2025 年，随着人工智能大模型的发展，手机、电脑等消费市场回暖以及机器人领域的创新都将带动集成电路产品的销售。根据美国半导体行业协会（SIA）预估，2025 年全球半导体销售额有望实现两位数增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）也预测，2025 年半导体销售额将达到 6,972 亿美元。

2、我国集成电路产业发展情况

2024 年是我国高新技术产业蓬勃发展的一年，新质生产力推动了新能源汽车、集成电路、人工智能、机器人等关键领域的发展和进步。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会数据，2024 年我国集成电路设计业销售额为 6,460.4 亿元，从销售额过亿元的设计企业看，2024 年达 731 家，同比增加 106 家，同比增长 17%。根据国家统计局数据，2024 年我国集成电路产量为 4,514.2 亿块，

同比增长 22.2%。

根据海关数据，2024 年我国进口集成电路 5,492 亿块，同比增长 14.6%，进口金额 3,856.45 亿美元，同比增长 10.4%；出口集成电路 2,981 亿块，同比增长 11.6%，出口金额 1,594.99 亿美元，同比增长 17.4%。从进出口均价看，2024 年，我国集成电路进口均价仍呈现下降趋势，出口均价开始有所上升，反映出我国集成电路产业链正日益完善，从设计、制造到封装测试的能力不断提升，并逐步向高附加值产品转型，推动了我国集成电路进出口产品结构的优化。

3、封装测试产业发展情况

集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。对于集成电路垂直分工的商业模式，由设计公司完成集成电路设计后委托给芯片制造厂生产晶圆，再委托封测厂进行封装测试，然后销售给电子整机产品生产企业。

从全球市场来看，封装测试行业市场集中度较高且较为稳定，行业前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业所占据，近年来全球前十大企业市场份额达到 75%以上，而且有进一步提高的趋势。

在我国集成电路产业链中，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，封装测试业是唯一能够与国际企业全面竞争的产业，包括公司在内的国内主要封装测试企业在技术水平上已经和外资、合资企业基本同步，竞争实力逐渐增强。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模居全球集成电路封测行业前十大之列。

4、国家支持集成电路产业发展的相关政策

集成电路产业的技术水平和发展规模已成为衡量产业竞争力和综合实力的重要标志，国家明确将集成电路产业的发展上升至国家战略，并连续出台了一系列产业支持政策。国务院 2020 年 7 月出台的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策八个方面给予集成电路企业政策支持。2021 年 3 月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，将集成电路作为原创性引领性科技攻关产业之一。党

的二十大报告强调，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。中共中央 2024 年 7 月审议通过的《关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出，抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。

在国家出台相关鼓励集成电路产业发展的政策后，全国主要集成电路产业聚集地则根据各自情况出台了地方集成电路产业发展政策。随着国家及地方支持政策的出台、实施，将有力促进我国集成电路产业发展，集成电路产业将迎来新的发展机遇。

二、2024 年度公司经营情况

2024 年，集成电路行业重新进入复苏增长周期，公司订单同比大幅增长，各季度营业收入均实现同比、环比正增长，并于四季度实现新高。2024 年，公司共完成集成电路封装 575.14 亿只，同比增长 22.56%，晶圆级集成电路封装 176.42 万片，同比增长 38.58%；完成营业收入 144.62 亿元，同比增长 28.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.16 亿元，同比增长 172.29%。2024 年公司主要工作开展情况如下：

1、贯彻以客户为中心的理念，抢抓市场逐步恢复的有利时机，进一步巩固销售部门联合技术部门和各子公司共同负责制的市场开发管理模式，加大客户开发和客户关系维护力度，集中资源保障重要客户的订单交付和服务工作，大力发挥公司在境内市场的份额优势，努力做好境外客户订单稳步上量。报告期内，公司境内和境外销售收入分别达到 92.68 亿元和 51.94 亿元，同比分别增长 35.75% 和 16.16%，存储器、bumping、汽车电子等产品订单大幅增长，新开发客户 236 家，产品结构和客户结构优化工作稳步推进。

2、公司持续进行先进封装技术和产品的研发及量产工作，推进 Chiplet、汽车电子、板级封装平台相关技术的研发。公司完成了 2.5D 产线建设和设备调试，FOPLP 技术通过客户认证，完成汽车级 Grade 0、双面塑封 SiP 封装技术开发，基于 TMV 工艺的 uPOP、大颗高散热 FCBGA、5G 毫米波 AiP、车载激光雷达产

品均实现量产，超高集成度 uMCP 具备量产条件。

报告期内，公司获得授权专利 29 项，其中发明专利 26 项。

3、在市场内卷的竞争格局下，公司坚持质量底线，实施“客户—制程—原材料”的质量联动管理机制，通过开展供方持续改进项目和精细化参数管理与拦截能力提升以及零缺陷质量管理活动，强化过程管控能力，提升封装产品质量。

4、持续进行生产自动化建设工作，推广实施公司及子公司在检验、上料、配送等方面自动化建设的方法和经验，完成 WLP、FC 产线全线自动化建设，推动公司生产效率不断提升。同时，公司积极开展降本增效工作，聚焦工艺优化、材料降本、损耗改善、国产化应用、管理提升等方面工作，不断降低生产成本，提高公司产品竞争力和经营效益。

5、公司结合市场发展和客户需求等情况，推进募集资金投资项目和新生产基地建设。截至报告期末，公司募集资金投资项目全部建设完成，产能正逐步释放，公司新生产基地华天江苏、华天上海已进入生产经营阶段，为公司进一步扩大产业规模，尤其是先进封装规模打下坚实的基础。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

1、2024 年 1 月 9 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 1 月 10 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2024 年 3 月 31 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《总经理 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于子公司继续履行实施募集资金投资项目厂房租赁关联交易合同的议案》、

《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 4 月 2 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过公司《2024 年第一季度报告》。

本次会议仅审议公司《2024 年第一季度报告》一项议案，未披露本次会议决议。《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2024 年 7 月 24 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2024 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度）》。

本次会议决议公告已于 2024 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2024 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过公司《2024 年第三季度报告》、《关于建立〈舆情管理制度〉的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2024 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

本次会议决议公告已于 2024 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024 年公司董事会召集了 2 次股东大会，会议具体情况如下：

1、2024 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。

2、2024 年 8 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议补选张玉明先生、杨柳先生为公司第七届董事会董事。

以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。

（三）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会四个专业委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专业委员会议事规则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了有力的支持。报告期内，各专业委员会履职情况如下：

报告期内，审计委员会审议了公司募集资金存放与使用情况、财务报表、内部日常审计以及专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了审计办公室 2023 年工作总结及 2024 年工作计划，对公司财务状况和经营情况进行了有效的指导和监督。审计委员会关注 2023 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，积极与年审注册会计师进行沟通，规范完成了 2023 年财务报告的审计工作。同时，审计委员会对审计机构 2023 年度审计工作进行了评价和总结，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度会计报表的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2023 年度财务报告的审计工作。

报告期内，薪酬与考核委员会审议了公司高级管理人员 2023 年度履职和薪酬情况、调整 2023 年股票期权激励计划行权价格、授予股票期权等事项。

报告期内，提名委员会对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要进行了评议、对董事候选人任职资格进行审查。

报告期内，战略发展委员会讨论和制定了公司 2024 年度经营目标。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，关注公司发展，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了独立监督作用。

四、2025 年度公司经营计划

根据行业特点和市场预测，2025 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 159 亿元。

2025 年主要开展以下工作：

1、继续发挥销售龙头作用，激发销售团队活力，关注市场变化和客户需求，做好重点客户服务和目标客户开发及导入工作，保障现有客户订单稳定增长和新导入客户的量产，努力争取订单，提高市场份额。

2、持续进行技术创新和先进封装技术的研发工作，加强市场洞察和细分市场研究，重点开展面向 AI、XPU、存储器以及汽车电子相关应用或产品的开发，推进 2.5D 平台技术的成熟转化，积极布局 CP0 封装技术。

3、深入推进质量文化建设，塑造质量品牌形象，通过开展关键材料质量管控、封装良率提升等工作，持续推动质量管理体系建设和公司封装产品质量水平提升。

4、持续开展精益生产和降本增效工作，总结推广自动化、智能化生产优秀实践，挖潜设备效率和管理效能，优化生产工艺流程，不断提高公司智能制造能力。

5、补充完善华天江苏、盘古半导体管理、技术、工程团队，做好量产准备，进行华天上海吸收合并纪元微科的相关工作，不断优化公司产业布局。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日